



MDI-ST SOLDERBEAM Single Table Machine

- Efficient solder mask system
- Standard Ink = <20s print time;
DI Ink = <10s print time
- Available resolutions: 30µm L/S or 15µm L/S
 - Min. SRO = 75 or 50 µm
 - Min. Dam = 50 or 30 µm

MDI-ST SOLDERBEAM Einzeltischmaschine

- Effizientes Soldermaskensystem
- Standard Lack = <20s Belichtungszeit;
DI Lack = <10s Belichtungszeit
- Verfügbare Auflösungen: 30µm L/S oder 15µm L/S
 - Min. SRO = 75 oder 50 µm
 - Min. Steg = 50 oder 30 µm



MDI-TTG | Tandem Table Machine

- Efficient Tandem Table system
(2x 24.4" x 36")
- Gantry-Mode option for large formats
(54" x 36")
- Flexible use of inner layers, outer layers,
solder and silver film applications.

MDI-TTG | Tandem-Tisch-Maschine

- Effizientes Tandem-Tischsystem
(2x 24,4" x 36")
- Gantry-Modus-Option für Großformate
(54" x 36")
- Flexible Nutzung von Innen-, Aussenlagen,
Solder und Silberfilm Anwendungen

NEW



MDI-SUB | Cross Table Machine

- **NEW** Highest Accuracy platform for 2µm L/S
resolution
- Supports up to 620 x 620 mm panel size
- High accuracy machine stage with cross-table

MDI-SUB | Kreuztischmaschine

- **NEU** Hochgenaue Maschinenplattform für 2µm
L/S Auflösung
- Unterstützt eine Panelgröße bis 620 x 620 mm
- Hochpräzise Maschinenbasis mit Kreuztisch



Laser Hybrid-Drilling: Endurance 1 Platform

- 1 Station platform with integrated flip-loader
and drawers
- Dedicated laser-head for UV-cleaning of
target layer
- Cross-Table design for highest accuracy

Laser-Hybrid-Bohren: Endurance 1 Plattform

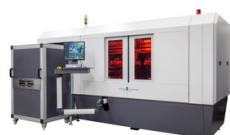
- 1-Stationen-Plattform mit integriertem Flip-
Loader und Schubladen
- Eigener Laserkopf zur UV-Reinigung der
Zielschicht
- Kreuztisch-Design für höchste Genauigkeit

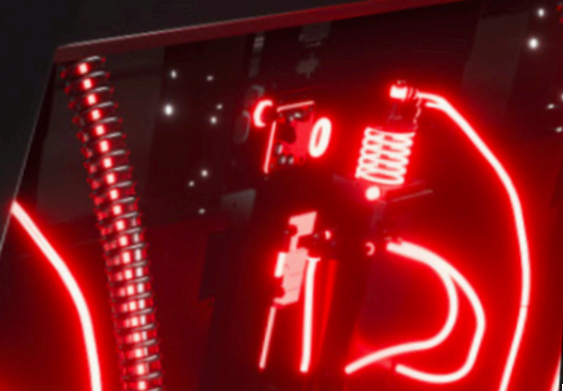
Laser MicroVias Drilling and Cutting: Endurance 2 Platform

- 2-Station platform with integrated flip-
loader and drawers
- Broad range of optical set-ups and laser
types for various applications
- Trolley with input-/output drawer for
flexible loading

Laser-MikroVias-Bohren und -Schneiden: Endurance 2-Plattform

- 2-Stationen-Plattform mit integriertem Flip-
Loader und Schubladen
- Breites Spektrum an optischen Setups und
Lasertypen für verschiedene Anwendungen
- Trolley mit Ein-/Ausgabeschublade für
flexible Beladung





Laser MicroVias Drilling and Cutting Variance Platform

- All new housing and Further reduced footprint
- Integrated motorized Beam-Expander and -Shaper
- Multiple laser choice: UV-nanosecond, IR-/Green-/UV-picosecond



AGV solution: ALS 1 with Modul

- Supporting many Machines with one Shuttle
- Compact and Flexible layouts
- Manless drilling for 24/7



Drilling/Routing: Modul DH CCD

- **NEW** S80 CNC System
- Compact and Flexible
- XRAY Process with CCD unit



BackDrilling/HDI Drilling: EXY-4-2228

- Back-drilling 4.0 with highest accuracy
- Drill In Center
- Different scaling functions, including non-linear
- Auto Collet Cleaning



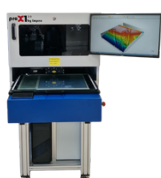
Registration: XRA3

- Perfect contrast even with difficult build-ups, ideal for IMS products (powerful XRAY source up to 90 kV)
- Patented Flextable - no limits for measuring and drilling
- Drill in center accuracy: 9 µm



Flash Cutting: MBM 2.0

- **NEW:** Registration using XRAY-Systems
- Flash cutting and contour processing in one step
- No extra waste system for flash required (direct exhausting)



Measuring Machine | ProX1²

- Quick First-Article check, incoming inspection or sorting
- Small space requirement
- Highspeed 2D and 3D Analysis

Laser-MicroVias-Bohren und Schneiden Variance Platform

- Alle Neubauten und weiter verringerter Fußabdruck
- Integrierter motorisierter Beam-Expander und -Shaper
- Mehrere Laseroptionen: UV-Nanosekunden, IR-/Grün-/UV-Pikosekunden

AGV-Lösung: ALS 1 mit Modul

- Unterstützung mehrerer Maschinen mit einem Shuttle
- Kompakte und flexible Layouts
- Mannlose Bohrarbeiten rund um die Uhr

Bohren/Fräsen: Modul

- **NEU** S80 CNC-System
- Kompakt und flexibel
- XRAY-Prozess mit CCD-Einheit

Backdrilling/HDI-Bohren: EXY-4-2228

- Back-Drilling 4.0 mit höchster Genauigkeit
- Drill in der Mitte
- Verschiedene Skalierungsfunktionen, einschließlich nichtlinearer
- Automatische Spannzangenreinigung

Registration: XRA3

- Perfekter Kontrast bei schwierigen Aufbauten, ideal für IMS Produkte (leistungsstarke Röntgenquelle bis zu 90 kV)
- Patentierter Flextisch - Keine Einschränkung für Messen und Bohren
- Drill in center Genauigkeit: 9 µm

Rückschnitt: MBM 2.0

- **NEU:** Registrierung mittels XRAY-System
- Rückschnitt und Kantenkonturbearbeitung in einem Arbeitsschritt
- Kein extra Abfallsystem nötig (direkter Absaugungsanschluss)

Messmaschine | ProX1²

- Schnelle Erstmusterkontrolle, Eingangskontrolle oder Sortierung
- Geringer Platzbedarf
- Highspeed 2D und 3D Analyse